

证券代码： 603690

证券简称：至纯科技

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 券商策略会 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与机构	人保资产、野村资管、德邦证券、华创证券、东证创投、东方证券、易方达基金、华泰证券、亚太财险、华安基金、威灵顿投资管理、浙商证券、长江证券
时间	2024年5月
地点	现场会议
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理蒋渊，董秘任慕华，证代张娟
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、 交流的主要问题及回复概要</p> <p>1、公司 23 年收益如何？</p> <p>答：公司 2023 年实现营业收入 31.51 亿元，同比增长 3.33%；净利润 3.77 亿元，同比增长 33.58%；扣非后净利润 1.02 亿元，同比下降 64.25%。扣非后净利润下降主要为公司新增贷款的利息支出增加、受外汇影响的汇率波动损失以及合肥晶圆再生与部件清洗业务尚处于爬坡阶段未实现利润贡献，公司仍需承担相应的成本。净利润增长主要是由于公司处置了部分股权产生的投资收益及公允价值变动产生的收益。其他具体财务信息请见公司 2023 年年度报告。</p> <p>2、公司 2023 年新签订单情况如何，大宗气站业务是否有新增？</p>

答：2023 年度公司新增订单总额为 132.93 亿元，其中包含电子材料及专项服务 5 年-15 年期长期订单金额 86.61 亿元，其中包括大宗气站业务。成功收获上述长期订单体现了公司经营战略中的子战略“将技术和产品服务化”初步彰显成效。

3、公司报告称有 132 亿订单在手，请问目前是否能正常交付呢？

答：2023 年度公司新增订单总额为 132.93 亿元，其中包含电子材料及专项服务 5 年-15 年期长期订单金额 86.61 亿元。长期订单在 5-15 年的期间内交付，其余订单根据生产或建设周期正常交付。

4、公司 24 年产品规划有什么打算吗？

答：公司目前主要服务于集成电路领域，深耕半导体制程设备、工艺支持设备及相关系统以及由此衍生的部件材料与专项服务。2024 年，公司预计年度新增订单区间在 55-60 亿元（不含 5-15 年长期订单），制程设备订单区间为 15-20 亿元。

公司布局的制程设备、工艺支持设备、工艺系统、部件材料与专项服务，立足于相同的能力圈，均紧扣“微纳污染控制技术”，贯穿用户从新建扩建工厂到稳健运营乃至技术升级的全生命周期。公司布局的产品线已经在部分核心用户形成全面合作，作为战略供应商给用户贡献价值。

公司将跟动客户需求，不断响应制程精度要求，并立足自身的技术、资源，满足核心客户生产链多环节的多样需求，为客户提供全生命周期的产品与服务。

5、公司在手订单充沛，请问订单从签约到交付后回款的大概周期需要多久？

答：根据业务类别不同，订单交付回款周期有所区别。公司系

统集成业务根据项目大小建设周期为半年至两年不等，建设完成、客户验收后确认收入；半导体制程设备类业务，生产周期通常为9-12个月，按生产及交付的节点确认收入；大宗气站类业务属于长期服务业务，根据合同约定一般按月或按季度收取租金及供气费。

6、新“国九条”提出，要增强分红稳定性、持续性和可预期性，推动一年多次分红、预分红、春节前分红。请问，公司对未来分红有何考虑和规划？如何在维持高分红和加大资本开支之间做好平衡？

答：公司上市以来持续分红，累计分红总额12,635.55万元，累计回购股份支付总额8,399.28万元。公司2023年度分红预案为每10股派发现金红利税前1.93元，合计拟派发现金红利7,418.68万元，同时公司2023年已实施的股份回购金额3,899.85万元视同现金分红，公司2023年实际累计现金分红11,318.53万元占2023年归属于母公司股东净利润30%。

公司近年来为把握日益增长的市场机遇，通过大力投入研发与提升产能建设，开发、验证新机型等以匹配业务的高速增长，从2017年至2023年，生产场地从0.9万平米扩展至37万平米，固定资产及在建工程超过20亿，研发投入从0.13亿元跃升至3.07亿元，高强度的研发投入和重资产投入带来利息和折旧影响，以及爬坡业务尚未到达盈利期间，都对扣非利润增长有一定的影响。随着爬坡业务进入盈利期间，且现金流改善、减少财务成本，公司的扣非后净利润将会有好的表现。公司会一如既往地做好主营业务，稳健持续地分红，积极回报投资者。

7、公司大宗气站的新业务情况如何了，后续拓展是否顺利？

答：由至纯科技投资和设计建设的国内首座完全国产化的12英寸晶圆对应28纳米及以上的大宗气体供应工厂指标完全达

标，供气至今持续稳定运行，成功打破了半导体级大宗气由国际供应商垄断的格局，实现了该制程节点国内自主大宗气站零的突破。公司的 2023 年新增订单中，即包括新签的大宗气站长期订单。在第一座大宗气站的先发优势下，公司大宗气站业务正有序拓展中。

8、公司去年设备业务情况怎么样？

答：公司子公司至微科技是国内湿法设备主要供应商之一，能够覆盖晶圆制造中包括逻辑电路、高密度存储、化合物半导体特色工艺等多个细分领域的市场需求。目前湿法设备在 28 纳米节点设备开发已经全部完成，且全工艺机台均有订单，在更先进制程节点，至微也已取得部分工艺订单。2023 年，公司湿法设备新增订单低于公司年初预期，高阶设备在订单获取的进度上受到用户扩产进度影响有所延后，但在高温硫酸、FINETCH、单片磷酸等尚被国际厂商垄断的机台领域，公司交付和验证进度都在国内领先。公司湿法高端产品包括 SPM 高温硫酸、去胶、晶背清洗等清洗设备取得突破，并交付给多家国内主流晶圆厂，其中至微的 S300 SPM 机台单设备在用户量产线上的累计产量截至 2024 年 4 月底已超过 50 万片，是高阶湿法设备国产替代进口的重要里程碑。目前至微是国内单片硫酸设备达到上述单机台量产指标的唯一厂商。

11、公司在湿法设备领域是否拥有显著优势的核心产品？

答：公司提供湿法清洗设备，包括湿法槽式清洗设备及湿法单片式清洗设备，聚焦晶圆制造的前道工艺，主要应用于扩散、光刻、刻蚀、离子注入、薄膜沉积等关键工序段前后。高端产品包括 SPM 高温硫酸、去胶、晶背清洗等清洗设备。

单片高温 SPM 工艺主要用在刻蚀以及离子注入之后的有机物清洗，目的是把晶圆表面反应后残余的光刻胶聚合物清除干净。

单片 SPM 工艺应用贯穿整个先进半导体的前、中段工艺，清洗工艺次数超过 30 道，是所有湿法工艺中应用最多的一种设备。此外 SPM 工艺被广泛应用在浅槽隔离（STI）、接触孔刻蚀后（CT）等高深宽结构，以及鳍式晶体管（FinFET）、电容（capacitor）等高度复杂图形区域，故 SPM 工艺被公认是湿法设备领域中性能要求较高的工艺，也是最具挑战的湿法工艺设备之一。至纯科技的单片 SPM 工艺取得关键突破，并达到了单机台累计超过 50 万片的产能贡献。此外公司开发硫酸回收系统与单片 SPM 设备搭配使用，最高可以实现 80% 以上的硫酸回收，单台每年可为用户节省 160~180 万美金的硫酸费用，同时降低用户在危废排放方面的压力。公司单片清洗机台设计采用类国际一流设备的架构，拥有自己专利和技术布局。目前多款产品的各项工艺指标可完全对标国际龙头大厂设备指标。

Backside clean（晶背清洗）和 Backside etch（背面蚀刻）工艺是在芯片制造工艺中相当重要的湿法工艺。晶圆表面洁净度会影响后续半导体工艺及产品的合格率，因此半导体生产过程中的污染控制至关重要，尤其是金属污染。早期曾有文献指出，在制造过程中，因未能有效去除晶圆表面的污染而产生的耗损，在所有产额损失中，可能占 50% 以上的比例。半导体生产设备中单价最高的是光刻机，晶圆背面清洗的功能就是将背面的金属污染物清除，把颗粒洗净，让晶圆以最佳状态进入光刻机，避免光刻机因晶圆背面缺陷问题（如金属和颗粒）而停机，并因此产生巨大损失。晶圆背面清洗的重要性及步骤数量随着工艺进步和金属层的增加而增加。目前国内晶圆厂商普遍采用由海外大厂制造的机台，至纯科技作为后起之秀，目前已实现 Backside clean（晶背清洗）和 Backside etch（背面蚀刻）功能，达到客户的验收标准。通过背面单片机台清洗后，可实现 40 纳米以上少于 10 个剩余颗粒的处理。同时金属污染可控制在 $1E+9$ （原子/平方厘米）以内。目前产品的各项工艺指标可精确对标国际大厂设备指标。